

募集要項

職種	■半導体プロセス用プラスチック射出成形品の設計開発
仕事の内容	■開発/設計 2D/3DのCADによる製品設計および製図
	■設計検証 流動解析、構造解析などCAE解析を含む検証
	■妥当性確認 金型、製品、工程など試作評価
	■機能検証 設計要件を満たしているか、成形品の機能評価
	■量産準備 図面、仕様書など技術文書の作成および整備
学歴	■四年制大学理系学部卒業者
能力・経験	■必須 工学系/機械工学/電気/高分子分野にまつわるバックグラウンドをお持ちの方 PCスキル（Excel、Word）、35歳以下の方（長期勤続によるキャリア形成）
	■歓迎 CADを使用した設計や射出成形品の設計経験
勤務地	■東京本社 東京都港区芝浦4丁目15番33号 芝浦清水ビル
転勤	■無

勤務条件

雇用形態	■正社員（期間の定め：無） 定年60歳（65歳まで継続雇用制度有）
	■試用期間 有6カ月（試用期間中の勤務条件：変更無）
就業時間	■9：00～17：00（休憩45分） 実働7時間15分
給与	■月額：194,100円～356,100円（基本給＋住宅手当） 基本給：184,100円～338,100円 住宅手当：10,000円～18,000円
	■各種手当 家族手当：4,000円～8,000円/扶養家族1人あたり 通勤手当：上限40,000円 時間外手当：残業時間に応じて別途支給
	■昇給：年一回（4月）
賞与	■年二回（7月、12月）
休日・休暇	■年間休日125日 内訳：完全週休二日制（土日祝）、夏季休暇、年末年始休暇
	■有給休暇 入社後半年経過時点10日 最高付与日数20日
	■ほか休暇・休業制度 慶弔休暇（有給）、育児・介護休業（無給）など
社会保険	■厚生年金保険、健康保険、労働保険（労災・雇用）
採用実績校	群馬大学 東北学院大学 富山大学 日本大学 前橋工科大学 山形大学 ほか